

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: PROSIDING

Judul karya ilmiah (paper) : Deposition Time Variation On Thickness And Resistivity Of Cu/Ni Thin Fil Obtained By Magnetic Field-Assisted Electroplating Process

Jumlah Penulis : 4 orang

Nama Penulis : Muthi'ah Lutfi Khansa, Moh. Toifur, Azmi Khusnani, Yudhiakto Pramudya

Status Pengusul : Penulis Tunggal/Penulis pertama/penulis ke 2 /penulis korespondensi **

Identitas Prosiding : a. Judul Prosiding : The 2019 Conference On Fundamental And Applied Science For Applied Science For Advanced Technology
 b. ISBN/ISSN :
 c. Tahun terbit, tempat pelaksanaan :
 d. Penerbit/organizer : IOP Publishing
 e. Alamat Repository PT/web prosiding : <https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1373/1>
 f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 (beri v pada kategori yang tepat) Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	1,5 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5		4,0
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5		3,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/prosiding (30%)	4,5		4,0
Total = (100%)	15		13
Nilai Pengusul	2		1,7
Komentar Peer Review	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : <i>Artikel telah memenuhi unsur kelengkapan dan kesesuaian sebagai artikel dalam prosiding internasional.</i> 2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan :		

Pembahasan cukup mendalam ditunjukkan
dg karakteristik yg telah dilakukan.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :

Cu/Ni tetap saja menarik utk di teliti
sebagai bahan sensor temperatur.

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :

IOF Publishing sebagai penerbit yg
telah banyak menerbitkan berbagai
kegiatan seminar Internasional

5. Indikasi plagiasi :


Saya belum menemukan plagiasi
pada artikel ini.

6. Kesesuaian bidang ilmu :

Sesuai dlm bidang Fisika Material

2020

Reviewer 1/2 **


Nama Prof. Ariswanto
NIP/NIY. 195305141981031003
Bidang Ilmu Fisika Material
Jabatan Akademik Guru Besar
Unit Kerja FMIPA UNY

*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: PROSIDING

Judul karya ilmiah (paper) : Deposition Time Variation On Thickness And Resistivity Of Cu/Ni Thin Fil Obtained By Magnetic Field-Assisted Electroplating Process

Jumlah Penulis : 4 orang

Nama Penulis : Muthi'ah Lutfi Khansa, Moh. Toifur, Azmi Khusnani, Yudhiakto Pramudya

Status Pengusul : ~~Penulis Tunggal/~~Penulis pertama/penulis ke 2 /~~penulis korespondensi~~ **

Identitas Prosiding : a. Judul Prosiding : The 2019 Conference On Fundamental And Applied Science For Applied Science For Advanced Technology
 b. ISBN/ISSN :
 c. Tahun terbit, tempat pelaksanaan :
 d. Penerbit/organizer : IOP Publishing
 e. Alamat Repository PT/web prosiding : <https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1373/1>
 f. Terindeks di (jika ada) :

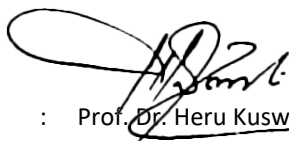
Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 (beri V pada kategori yang tepat) Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	1,5		1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5		4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5		4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/prosiding (30%)	4,5		4,5
Total = (100%)	15		14
Nilai Pengusul	2		
Nilai Reviewer	Penulis kedua dari empat penulis = (40%/3) X 14 =		1,87

Komentar Peer Review	<p>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : Tullisan terdiri atas; Judul, Penulis, Abstrak, , Introduction, Research Methods, Results and discussion, Conclusion, Acknowledgment, References.</p> <p>2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : Tulisan membahas ketebalan dan resistivitas lapisan tipis Cu/Ni yang dibuat electroplating. Ada stu gambar hasil yang dianalisis menjadi gambar lain yang menyajikan karakteristik ketebalan dan resistivitas sebagai fungsi waktu. Pembahasan dengan membandingkan hasil dari refrensi [20]</p> <p>3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : Metode yang digunakan mengacu pada [20]. Ada 20 refrensi. Paling baru 2018.</p> <p>4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : Makalah disajikan pada The 2019 Conference On Fundamental And AppliedScience For Applied Science For Advanced Technology. Proceeding diterbitkan oleh Journal of Physics Conference Series</p> <p>5. Indikasi plagiasi : -</p> <p>6. Kesesuaian bidang ilmu : Tulisan berkaitan dengan Fisika, sesuai dengan bidang ilmu penulis</p>
-----------------------------	--

Yogyakarta, 14 Mei 2020
Reviewer 1/2 *



Nama : Prof. Dr. Heru Kuswanto, M.Si
NIP : 196111121987021001
Bidang Ilmu : Fisika
Jabatan Akademik : Guru Besar
Unit Kerja : FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta